

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2022년 10월 27일 (27.10.2022) WIPO | PCT



(10) 국제공개번호
WO 2022/225263 A1

- (51) 국제특허분류:
H04M 1/02 (2006.01) H04R 3/02 (2006.01)
H04M 1/03 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/005467
- (22) 국제출원일: 2022년 4월 15일 (15.04.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2021-0051871 2021년 4월 21일 (21.04.2021) KR
- (71) 출원인: 삼성전자 주식회사 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) [KR/KR]; 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 최규원 (CHOI, Kyuwon); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 김태훈 (KIM, Tachun); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 이영선 (LEE, Youngsun); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 허재영 (HUH, Jaeyoung); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 권혁록 등 (KWON, Hyuk-Rok et al.); 03173 서울특별시 종로구 새문안로 5길 19, 11층, Seoul (KR).

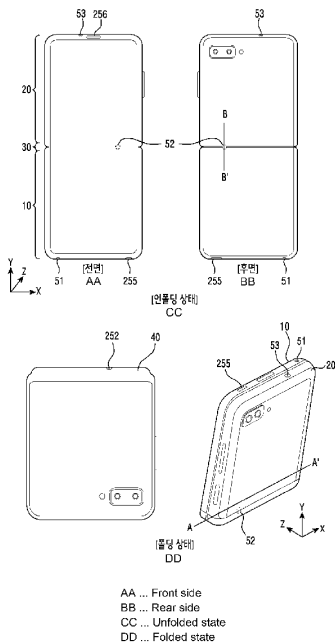
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE AND OPERATION METHOD THEREFOR

(54) 발명의 명칭: 전자 장치 및 그의 동작 방법



(57) Abstract: According to a particular embodiment, an electronic device may comprise: a first housing; a first substrate disposed on the first housing; a second housing; a second substrate disposed on the second housing; a flexible printed circuit board connecting the first substrate to the second substrate; a hinge module for hingeably connecting the first housing to the second housing; a hinge cover including a microphone hole and covering the hinge module; at least one first microphone disposed on the first housing; a speaker disposed in the second housing; and at least one second microphone which is disposed on the hinge module, collects external sound through the microphone hole formed in the hinge cover, and is mounted on a portion extending from the flexible printed circuit board.

(57) 요약서: 특정 실시 예에 따르면, 전자 장치는: 제1 하우징; 상기 제1 하우징에 배치된 제1 기판; 제2 하우징; 상기 제2 하우징에 배치된 제2 기판; 상기 제1 기판과 상기 제2 기판을 연결하는 연성인쇄회로기판; 상기 제1 하우징과 제2 하우징을 힌지 가능하게 연결하는 힌지 모듈; 마이크 홀을 포함하고 힌지 모듈을 덮는 힌지 커버; 상기 제1 하우징에 배치된 적어도 하나의 제1 마이크; 제2 하우징에 배치되는 스피커; 및 상기 힌지 모듈에 배치되고, 상기 힌지 커버에 형성된 상기 마이크 홀을 통해 외부 소리를 수집하고, 상기 연성인쇄회로기판에서 연장되는 부분에 장착되는 적어도 하나의 제2 마이크를 포함할 수 있다.

WO 2022/225263 A1